

中国集成电路设计业 2021 年会  
暨无锡集成电路产业创新发展高峰论坛  
CSIA-ICCAD 2021 Annual Conference &  
Wuxi IC Industry Innovation and Development Summit  
会议日程  
Agenda

2021 年 11 月 11 日，星期四  
Nov. 11, Thursday, 2021

地点：无锡太湖国际博览中心 A6 馆  
Venue: A6 Hall, 2F, Wuxi Taihu International Expo Center

时间 Time	内 容 Contents
<b>开 幕 式</b> <b>Opening Ceremony</b>	
主持人： <b>Moderator:</b>	
08:30-09:00	中国半导体行业协会领导致辞 Address, Leader of CSIA
	领导、嘉宾致辞 Address, Leader and Guest
	无锡市人民政府领导致辞 Address, Leader of Wuxi Municipal People's Government
<b>高峰论坛</b> <b>Top Forum</b>	
主持人：程晋格，中国半导体行业协会集成电路设计分会秘书长 <b>Moderator: Jinge Cheng, General Secretary, CSIA-ICCAD</b>	
09:00-09:30	Keynote - 魏少军教授，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长 - Prof. Shaojun Wei, General Director, CSIA-ICCAD
09:30-09:50	- 无锡市工信局 -
09:50-10:10	数字潮起，EDA 芯生 - 葛群，新思科技全球资深副总裁兼中国董事长 EDA Empowering the Rise of Digitalization - Qun Ge, Global Senior Vice President and China Chairman, Synopsys
10:10-10:30	三项关键准备，迎接下一个芯片黄金十年 - 林伟圣，和舰芯片制造（苏州）股份有限公司副总经理 Challenges and Opportunities Post-Pandemic - W S Lin, VP, HeJian Technology (Suzhou) Co., Ltd.
10:30-10:50	国产数字芯片 EDA 新前沿：AI，云，异构计算 - 王宇成，深圳鸿芯微纳技术有限公司 CTO -

10:50-11:10	新一轮“超级周期”唤醒半导体产业新动能 - 彭启煌, 西门子 EDA 全球资深副总裁, 亚太区总裁 The Exciting New Super-Cycle in Semiconductor - Danny Perng, Senior Vice President, PacRim, Siemens EDA
11:10-11:30	Chiplet 的产业化之路 - 戴伟民, 芯原股份创始人、董事长兼总裁 The Roadmap to Deploy Chiplet - Wayne Dai, Chairman, President and CEO, VeriSilicon
11:30-11:50	- 罗镇球, 台积电(中国) 总经理 - Roger Luo, President, TSMC China
11:50-12:10	- 汪晓煜, Cadence 公司中国区总经理 - Xiaoyu Wang, GM of China, Cadence Design Systems, Inc.
12:10-13:20	自助午餐 <b>Buffet Lunch</b>
主持人: 陈大同, 中国半导体行业协会 IC 设计分会副理事长 <b>Moderator: Datong Chen, Vice General Director, CSIA-ICCAD</b>	
13:15-13:20	幸运抽奖 <b>Lucky Draw</b>
13:20-13:40	核芯动力XPU: 定义全新的融合计算架构 - 吴雄昂, 安谋科技执行董事长兼首席执行官 XPU: Defining the New Multi-Domain Specific Architecture (xDAS) - Allen Wu, Executive Chairman & CEO, Arm China
13:40-14:00	- 彭进, 中芯国际集成电路制造有限公司资深副总裁 - John Peng, SVP, SMIC
14:00-14:20	自主 EDA 发展之路 - 刘伟平, 华大九天董事长 The Development Road of Domestic EDA Industry - Weiping Liu, Chairman, Empyrean Technology Co., Ltd.
14:20-14:40	开创更广阔的新纪元 - 王光伟, 格芯副总裁兼中国区销售总经理 Delivering an Era of More - Gary Wang, VP, GM of China Sales, GlobalFoundries
14:40-15:00	半导体 IP 和芯片定制国产化的技术发展趋势 - 敖海, 芯动科技有限公司首席执行官 The Technology Localization Trend of Silicon IP and Custom ASIC - Gordon Ao, CEO, INNOSILICON Technology Ltd.
15:00-15:20	通用算力的需求与机遇 - 陈维良, 沐曦集成电路(上海)有限公司 CEO The Demands and Opportunities of General-purpose Computing - William Chen, CEO, MetaX Integrated Circuits (Shanghai) Co., Ltd.
15:20-15:35	茶歇, 交流, 抽奖 <b>Coffee Break, Lucky Draw</b>
15:35-15:55	应用牵引, 立足创新, 构建芯片验证新生态 - 王礼宾, 芯华章科技董事长兼 CEO Building a New Ecology of Chip Verification with Application and Innovation - Alex Wang, Chairman and CEO, X-EPIC
15:55-16:15	一站式芯片设计和供应链平台, 助力芯片产业实现降本增效 - 张竞扬, 摩尔精英董事长兼 CEO One-stop IC Design and Supply Chain Platform to Improve Efficiency - JY Zhang, Chairman & CEO, MooreElite

16:15-16:35	<p>联动设计与制造，打造创新 EDA 解决方案</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 刘志宏博士，上海概伦电子股份有限公司董事长兼 CEO</li> <li>- Dr. Zhihong Liu, Chairman and CEO, Primarius Technologies Co., Ltd.</li> </ul>
16:35-16:55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 华润微电子</li> <li>-</li> </ul>
16:55-17:15	<p>Tower Semiconductor – 引领模拟生态系统，创造全周期价值</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 秦磊，Tower Semiconductor 中国区运营副总裁</li> </ul> <p>Tower Semiconductor – Leading the Analog Ecosystem with Full Circle Value Creation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lei Qin, VP of China Operations, Tower Semiconductor Ltd.</li> </ul>
17:15-17:35	<p>区域集成电路产业生态打造的思考和实践</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 时龙兴，东南大学首席教授，南京集成电路产业服务中心 (ICisC) 主任</li> </ul> <p>Thinking and Practice of Building a Regional Integrated Circuit Ecosystem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Longxing Shi, Currently the Chief Professor of Southeast University, the Director of Nanjing Integrated Circuit Industry Service Center (ICisC)</li> </ul>
17:35-17:40	幸运抽奖 <b>Lucky Draw</b>
17:40-19:00	观展与交流 <b>Visiting Exhibition</b>
19:00-21:00	<p>欢迎晚宴 (Synopsys 公司赞助)</p> <p><b>Welcome Dinner Banquet (Sponsored by Synopsys)</b></p> <p>地点：无锡太湖国际博览中心 A6 馆</p> <p><b>Site: A6 Hall, 2F, Wuxi Taihu International Expo Center</b></p>

2021年11月12日，星期五  
**Nov. 12, Friday, 2021**  
**专题论坛（一）**  
**Subject Forum ( I )**

地点：无锡君来世尊酒店一楼梅花厅 A

Venue: Mei Ballroom A, 1F, Worldhotel Grand Juna Wuxi

时间 Time	内容 Contents	演讲人 Lecturer
<b>IP 与 IC 设计服务（一） IP and IC Design Service (I)</b>		
主持人：余成斌，中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长 Moderator: Seng-Pan (Ben) U, Vice General Director, CSIA-ICCAD		
08:40-09:00	国产高性能接口 IP 的进展和量产解决方案 Progress of Domestic High-performance Interface IP and Mass Production Solutions	高专，芯动科技有限公司 VP/技术总监 Zachary Gao, VP/Technical Director, INNOSILICON Technology Ltd.
09:00-09:20	专注打造精品 IP，以匠心成就客户	李孟璋，芯耀辉科技有限公司 CTO MC Lee, CTO, Akrostar Technology Co., Ltd.
09:20-09:40	平板电脑高性能应用处理器芯片及软件解决方案 High Performance Application Processor and Software Solution for Tablet Computer	汪志伟，芯原股份高级副总裁、系统平台解决方案事业部总经理 Zhiwei (Wiseway) Wang, SVP, GM of System Platform Solution Division, VeriSilicon
09:40-10:00		安谋科技 Arm China
10:00-10:20	锐成芯微 WiFi6 射频 IP 加速新一代物联网芯片崛起 Actt WiFi6 RF IP Accelerates the Development of Next Generation IoT SoC	杨毅，成都锐成芯微科技股份有限公司 VP Yi Yang, VP, Chengdu Analog Circuit Technology Inc.
10:20-10:40	重塑人们出行方式的硅基平台 Reform the Way People Move by Silicon Platform	杨宜，索喜科技（上海）有限公司总经理 Rayman Yang, GM, Socionext Shanghai
10:40-11:00	私有云在 IC 验证中的应用 Private Cloud in IC Verification	王登宝，华桑电子无锡分公司总经理兼技术总监 Dengbao Wang, CTO, Newtouch Electronics
11:00-11:20	Maximizing SoC Bandwidth using Dynamic Voltage and Frequency Scaling	Andrew Cole, Randy Caplan, Silicon Creations
11:20-11:40	IP 国产化的困境与芯思原的破局思考 The Dilemma of IP Localization and VeriSyno's Thinking	王尚元，芯思原微电子有限公司技术支持经理 Shangyuan Wang, Technical Support Manager, VeriSyno Microelectronics Co., Ltd.

11:40-12:00	国产 FPGA 赋能 ADAS Domestic FPGA Empowers ADAS	王添平, 广东高云半导体科技股份有限公司 CTO TP Wang, CTO, GOWIN SEMICONDUCTOR CORP.
12:00-12:05	幸运抽奖 Lucky Draw	
12:05-13:10	自助午餐 Buffet Lunch	
主持人: 徐璐琦, 中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长 Moderator: Luqi Xu, Vice General Secretary, CSIA-ICCAD		
13:10-13:30	专业设计服务助力客户成功 Professional Design Services Help Customers Succeed	闫银宝, 上海申首半导体科技有限公司副总经理 Rimbo Yan, VP, Shanghai S1semi Technology Co., Ltd.
13:30-13:50	先进 GPU 架构赋能数字化升级	艾克, 颖脉信息技术(上海)有限公司技术总监 Ke Ai, Director of Applications Engineering, Imagination
13:50-14:10		Secure-IC
14:10-14:30	新世代芯片互联技术, 重新定义系统设计 Next Generation Chip Interconnection Technology Redefines System Design	陈博宇, OpenFive 高级销售总监 Alex Chen, Senior Sales Director, OpenFive China
14:30-14:50	IP 定制, 为 IC 设计加速助力 IP Customization Accelerates IC Design	罗培君, 四川和芯微电子股份有限公司销售经理 Peijun Luo, Sales Manager, IPGoal Microelectronics (Sichuan) Co., Ltd.
14:50-15:10	中科芯蕊-国产超低功耗 MCU 的创新领导者 Zhongke Xinrui-Innovative Leader of Ultra Low Power MCU	胡晓宇, 北京中科芯蕊科技有限公司总经理 Xiaoyu Hu, CEO, Beijing Zhongke Xinrui Technology Co., Ltd.
15:10-15:30	AI 赋能 IoT 行业新的机遇 AI Enables New Opportunities in the IoT Industry	宋一平, CEVA 公司 OEM BD Patrick Song, OEM Business Development, CEVA
15:30-15:50	基于 RISC-V 的嵌入式安全域 IP SECURITY ENCLAVE Based on RISC-V	谢林, SilexInsight 大中华区负责人 Tony Xie, Head of Greater China, SilexInsight
15:50-16:10	IC 设计中的颠覆 — AI & ML Disruptions in IC Design – AI & ML	卡蒂克, 智权半导体科技(厦门)有限公司总经理 Karthik Gopal, Asia GM, SmartDV Technologies
16:10-16:30		摩尔精英 MooreElite
16:30-16:50	通过 RISC-V 使能的 AIoT 系统挖掘数字化价值 Capture Value of Digitization via RISC-V Enabled AIoT System	江朝晖, 广东跃昉科技有限公司 CEO/CTO Aglaia Kong, CEO/CTO, GuangDong LeapFive Technology Co., Ltd.

16:50-17:10		兰文丽, 北京电子城集成电路设计服务有限公司总经理 Wenli Lan, GM, Beijing Electronics Zone Integrated Circuit Design and Service Co., Ltd.
17:10-17:30	“即插即用”模块加速新型 AI 芯片的设计实现 "Plug-n-Play" Modules Accelerate Implementation of New ML/AI ASIC Designs	张爱东, 顺卓微电子(西安)有限公司亚太区工程部负责人 Albert Zhang, Regional Head of Engineering APAC, Sondrel (Xi'an) Co., Ltd.
17:30-17:50		Alchip 世芯
17:50-17:55	幸运抽奖 Lucky Draw	
18:30-20:00	闭幕晚宴及交旗仪式 Closing Banquet and Flag Handover Ceremony 地点: 无锡太湖华邑酒店四楼新城厅 Site: Xincheng Ballroom, 4F, Hualuxe Wuxi Taihu	

2021年11月12日, 星期五  
**Nov. 12, Friday, 2021**  
**专题论坛 (二)**  
**Subject Forum (II)**

地点: 无锡君来世尊酒店一楼梅花厅 B

Venue: Mei Ballroom B, 1F, Worldhotel Grand Juna Wuxi

时间 Time	内容 Contents	演讲人 Lecturer
<b>IP 与 IC 设计服务 (二)</b> <b>IP and IC Design Service (II)</b>		
主持人: 李军, 中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长 <b>Moderator: Jun Li, Vice General Secretary, CSIA-ICCAD</b>		
08:40-09:00	创意电子 2.5D/3D 多芯片集成技术方案 实现介绍 - 助力 AI/HPC/Networking 等 芯片量产实现 GUC 2.5D and 3D Multi-die Integration Solution	肖有军, 创意电子股份有限公司上海 设计中心总监 YJ Xiao, Director, Global Unichip Corporation (GUC)/CIDS
09:00-09:20	今日设计, 赋能未来数据: 利用芯片遥测 技术进行全生命周期性能和可靠性监测 Designing Today for Data Tomorrow: Lifetime Performance & Reliability Monitoring using Chip Telemetry	Roger Lin, proteanTecs 大中华区应 用工程总监 Roger Lin, Director Application Engineering, Greater China, proteanTecs
09:20-09:40	台积电设计生态赋能产品创新, 共创美 好未来 Enabling Product Innovation for a Brighter Future: 2021 Design Ecosystem Update	陈敏, 台积电技术支持副总监 Amy Chen, Technical Support Deputy Director, TSMC
09:40-10:00	eNVM 技术, 让 BCD 工艺平台如虎添翼 Embedded Non-Volatile Memories Make BCD Platforms More Powerful	王明, 成都锐成芯微科技股份有限公 司器件研发总监 Samuel Wang, Device Director, Chengdu Analog Circuit Technology Inc.
10:00-10:20		上海佩纶半导体有限公司 peilunsemi
10:20-10:40		赛昉科技 StarFive
10:40-11:00	2009-2022 年 IP-XACT 标准的发展演变 IP-XACT's Evolution from 2009 to 2022	曾品翰, Arteris 中国区的技术支持经 理 William Tseng, Field Applications Engineer Manager, Arteris IP
11:00-11:20	55nm~14nm 自主开发 IP 及 SoC 平台加 速量产解决方案 Link to the Future: Faraday 5G Networking IP Solutions	孔晓彬, 智原科技 ASIC 技术顾问 Bruce Kong, ASIC Technical Consultant, Faraday
11:20-11:40	异构多核: 5G 和 AI 时代芯片核心设计技 术 Heterogeneous Multi-Core: Key Tech of 5G&AI Era Chip Design	谷建余, 无锡华大国奇科技有限公司 CEO Jianyu Gu, CEO, Qualchip Technologies, Inc.

11:40-12:00	后疫情时代, 如何迎接高性能运算、物联网与车用电子芯片的发展 In the Post-epidemic Era, How to Embrace the Development of HPC, IoT and Automotive Electronic Chips	王宏康, 芯测科技股份有限公司资深业务经理 Bill Wang, Senior Sales Manager, iSTART -TEK. INC.
12:00-12:05	幸运抽奖 Lucky Draw	
12:05-13:10	自助午餐 Buffet Lunch	
主持人: 赵建忠教授, 中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长 Moderator: Prof. Jianzhong Zhao, Vice General Secretary, CSIA-ICCAD		
13:10-13:30	安全信任根 – 守护芯片安全 Root of Trust – Secure Your Chip	包乌日吐, 深圳市纽创信安科技开发有限公司安全方案顾问 Stanley Bao, Security Solution Consultant, Open Security Research, Inc.
13:30-13:50	国产汽车电子关键技术突破与应用 Breakthrough and Application of Key Technology of Domestic Automotive Electronics	肖佐楠, 苏州国芯科技股份有限公司总经理 Joe Xiao, CEO, C*Core Technology Co., Ltd.
13:50-14:10	RISC-V 开放架构在“中国芯”进程中的机遇与挑战 The Opportunities and Challenges in Applying RISC-V Architecture to Build the Chinese Self-control Chips	李珏, 芯来科技市场及战略 VP Li Jue, Vice President of Strategy and Marketing, Nuclei
14:10-14:30	RISC-V 嵌入式处理器架构成为芯标准 RISC-V: A New Industry Standard	程明明, Andes 技术服务经理 Albert Cheng, Manager of Technical Service, Andes Technology
14:30-14:50	爱芯元智: AI ISP——人工智能视觉芯片的成像之美 Axera: AI ISP - How to get better video on Alvision chips	张兴, 爱芯元智 ISP 负责人、系统架构师 Xing Zhang, ISP System Architect, Axera
14:50-15:10	西门子旗下 EDA 产品 OneSpin 助力实现精确的验证覆盖率指标 Siemens EDA OneSpin: Precise Coverage Metrics Equals Higher Verification Quality	陈维嵬, OneSpin: a Siemens Business 中国区技术经理 Wei Wei Chen, Technical Manager for China, OneSpin: a Siemens Business
15:10-15:30	加速处理器核心设计自动化 Design Automation for Accelerating Processor Core Design	相海英, Cudasip 中国总经理, Tina Xiang, China GM, Cudasip
15:30-15:50	基于 RF SOI 的 NB IoT 射频前端 NB IoT Front End based on RF SOI	杨文伟, 上海新微技术研发中心有限公司研发总监 Wenwei Yang, R&D Director, Shanghai Industrial uTechnology Research Institute
15:50-16:10	灿芯助力中芯国际先进工艺及生态系统 What can Brite Bring to the SMIC Ecosystem?	赵飞, 灿芯半导体(上海)股份有限公司项目管理总监 Timothy Zhao, TSM/PM Director, Brite Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.
16:10-16:30	打造先进存储芯片的一站式设计服务 Build the Advanced Storage Controller by One-stop Design Service	周明德, 得一微电子股份有限公司 IP 专家 Ming-Te Chou, IP Expert, YEESTOR Microelectronics Co., Ltd.



16:30-16:50	高速连接未来——国产接口 IP 深耕者 High-speed Connection Future-Domestic IP Interface Deep Tiller	祝杰, 牛芯半导体(深圳)有限公司 销售总监 Jie Zhu, Director, Shezhen Niuxin Semiconductor Co., Ltd.
16:50-17:10	不一样的 IP, 不一样的 ASIC Specialized IP, and Specialized ASIC	王洪鹏, 中茵微电子(南京)有限公司 执行董事 Jason Wang, Executive Director, JoinSilicon Microelectronics (Nanjing) Co., Ltd.
17:10-17:30	志翔科技为 IC 企业构建安全高效的研发 环境 ZShield: Secure the Workplace for IC Company	蒋天仪, 北京志翔科技股份有限公司 联合创始人 Tianyi Jiang, Co-Founder, Zshield Inc.
17:30-17:50	卡姆派乐 IDE 对 RISC-V 架构 HarmonyOS 应用开发的支持与优化 Compiler-dev IDE Support and Optimization for the HormonyOS Application Development on the RISC-V Architecture	王锋, 湖南卡姆派乐信息科技有限公司 CEO Feng Wang, CEO, Hunan Compiler Information Technology Co. Ltd.
17:50-17:55	幸运抽奖 Lucky Draw	
18:30-20:00	闭幕晚宴及交旗仪式 Closing Banquet and Flag Handover Ceremony 地点: 无锡太湖华邑酒店四楼新城厅 Site: Xincheng Ballroom, 4F, Hualuxe Wuxi Taihu	

2021年11月12日, 星期五  
**Nov. 12, Friday, 2021**  
**专题论坛 (三)**  
**Subject Forum (III)**

地点: 无锡君来世尊酒店一楼兰花厅 A

Venue: Lan Ballroom A, 1F, Worldhotel Grand Juna Wuxi

时间 Time	内容 Contents	演讲人 Lecturer
<b>先进封装与测试 (一)</b> <b>Advanced Packaging and Testing (I)</b>		
<b>主持人: 周荣, 中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长</b> <b>Moderator: Rong Zhou, Vice General Secretary, CSIA-ICCAD</b>		
08:40-09:00	“芯片-封装-系统”协同设计及其价值体现 Unleash the Value with Silicon-Packaging-System Co-Design	杨程, 长电科技设计服务事业部先进及系统级封装设计总监 Cheng Yang, Director of Advanced Packaging and SiP Design, Design Service BU, JCET Group
09:00-09:20		摩尔精英 MooreElite
09:20-09:40	先进封装中关于晶圆划片的几项技术应用 Several Technical Applications of Wafer Dicing in Advanced Packaging	余胡平, 沈阳和研科技有限公司副总经理 Huping Yu, GM, Shenyang Heyan Technology Co., Ltd.
09:40-10:00	逆向工程是否能加速中国“芯”的发展 Can Reverse Engineering Accelerate the Development of Chinese Cores?	贾丽娟, 上海聚跃检测技术有限公司技术总监 Lisa Jia, Technical Director, Juyue Inspection Technology Co., Ltd.
10:00-10:20	封装集成技术趋势与解决方案 Package Challenges On SiP & FHEC' Solutions	钟磊, 甬矽电子(宁波)股份有限公司, 研发总监 Zhong Lei, R&D Director, Forehope Electronic(NING BO) Co. Ltd.
10:20-10:40		日月光处长 ASE
10:40-11:00	高性能环氧塑封料解决方案 High Performance Epoxy Molding Compound Solution	王善学, 江苏科化新材料科技有限公司副总经理 Shanxue Wang, Dupty General Manager, Jiangsu KEHUA New Materials Technology Co., Ltd.
11:00-11:20		合肥矽迈
11:20-11:40	奈米探针在芯片电性上的应用 The Application of Nano-probe in IC Electric Failure Analysis	陈志荣, 蔚思博检测技术(合肥)有限公司工程处协理 Phil Chen, Director, VESP Technology Corp.

11:40-12:00	拥抱新工艺测试挑战，加速中国数“质”变革 Embracing New Test Technology Challenges Speed up China Digital Evolution	黄飞鸿，泰瑞达（上海）有限公司销售副总经理 Felix Huang, Sales Deputy GM, Teradyne (Shanghai) Co., Ltd.
12:00-12:05	幸运抽奖 Lucky Draw	
12:05-13:10	自助午餐 Buffet Lunch	
主持人：徐秀法，中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长 Moderator: Xiufa Xu, Vice General Secretary, CSIA-ICCAD		
13:10-13:30		华宇电子 Hisemi Electronics Technology Co., Ltd.
13:30-13:50		华天科技 HT-Tech
13:50-14:10	多端口射频前端与变频器件的测试方案 Multi-port RF Front-end and Inverter Components Testing Solutions	郭进龙，罗德与施瓦茨公司市场发展经理 Jinlong Guo, MDM, Beijing Rohde & Schwarz Communication Technology Co., Ltd.
14:10-14:30	后摩尔时代关键封装技术分析 Key Package Assembly Technology Analysis for Post - Moore's Law Era	王鹏，通富微电业务中心技术行销副总 Peng Wang, VP of TPM, TFME
14:30-14:50	封装 CIM 迈向全自动化的变革需要 Necessary Change for Back-End CIM to Transit to Full Automation	叶宇晖，上海哥瑞利软件有限公司全球MES产品总监 YAP EE HUEY, MES DIRECTOR, RCM Product Director, Shanghai Glorysoft Co., Ltd.
14:50-15:10	移动时代---超薄集成电路面临的机遇与挑战 Opportunities and Challenges for Ultra-thin Integrated Circuits in the Mobile Era	何忠亮，深圳市鼎华芯泰科技有限公司董事长 He Zhong Liang, Chairman, Shenzhen Ding Waa Sam Tai Technology Co., Ltd.
15:10-15:30	新一代数字 SOC 测试 Next Generation Digital SOC Test	葛樑，爱德万测试（中国）业务发展高级经理 Liang Ge, Senior Business Development Manager, Advantest China
15:30-15:50	先进失效分析技术在集成电路的应用 Application of Advanced Failure Analysis Skill in Integrated Circuits	陈清珑，苏试宜特检测技术有限公司失效工程处处长 Larry Chen, Division Manager, CHINAiSTI Testing Technology Co., Ltd.
15:50-16:10	得“芯”应手，是德科技高性能芯片测试之道 From Chipset to Cloud, Keysight helps on high performance IC test	阳任平，是德科技中国区 IC 行业经理 Renping Yang, Greater China IC Industry Manager, Keysight
16:10-16:30	晶圆级扇出封装技术 Wafer Level Fan-out Packaging Technology	吕书臣，江苏中科智芯集成科技有限公司销售市场总监 Shuchen Lv, Sales & Marketing Director, CASMEIT

16:30-16:50	多元化需求驱动 SiP 创新研究 Study on SiP Innovation Driven by Diversified Demands	方家恩, 锐杰微科技集团董事长 Jiaen Fang, Chairman of the Board, Rigger Micro Technologies
16:50-17:10	ATE 测试接口 PCB 设计与制造所面临的挑战和机会 Challenges and Opportunities in the Design and Manufacture of ATE Test Interface Board	周德祥, 天芯互联科技有限公司产品线总监 Russell Zhou, Product Director, Sky Chip Interconnect Technology Co., Ltd.
17:10-17:30	有机基板在模块化和异构集成发展路线上的重要性 The Importance of Organic Substrates for Modularization and Heterogeneous Integration	贝罗莎, 奥特斯(中国)有限公司事业部半导体业务部高级总监 Rozalia Beica, Business Line Semiconductors, AT&S BU MS
17:30-17:50	先进封测技术在 5G 产品中的应用 The Application of Advanced Package and Testing Technology in 5G Products	孙拓北, 深圳市中兴微电子技术有限公司封测量产部部长 Tuobei Sun, Director, Shenzhen Sanechips Technology Co., Ltd.
17:50-17:55	幸运抽奖 Lucky Draw	
18:30-20:00	闭幕晚宴及交旗仪式 Closing Banquet and Flag Handover Ceremony 地点: 无锡太湖华邑酒店四楼新城厅 Site: Xincheng Ballroom, 4F, Hualuxe Wuxi Taihu	

2021年11月12日, 星期五  
**Nov. 12, Friday, 2021**  
**专题论坛 (四)**  
**Subject Forum (IV)**

地点: 无锡君来世尊酒店一楼兰花厅 B

Venue: Lan Ballroom B, 1F, Worldhotel Grand Juna Wuxi

时间 Time	内容 Contents	演讲人 Lecturer
<b>无锡集成电路创新发展论坛</b> <b>Wuxi IC Innovation and Development Forum</b>		
主持人: <b>Moderator:</b>		
09:00-09:10		
09:10-09:20		
09:20-09:40		
09:40-09:55		
09:55-10:15		
10:15-10:35		
10:35-10:55		
10:55-11:15		
11:15-11:35		
11:35-11:50		
11:50-12:10		
<b>12:10-12:15</b>	<b>幸运抽奖 Lucky Draw</b>	
<b>12:15-13:10</b>	<b>自助午餐 Buffet Lunch</b>	
<b>资本与 IC 设计业</b> <b>VC and IC Design Industry</b>		
主持人: 孙坚, 石溪资本管理合伙人、中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长 <b>Moderator: Jian Sun, Vice General Secretary, CSIA-ICCAD</b>		
13:10-13:30	下一波——半导体行业新阶段 Next wave - IC Industry New Era	黄庆博士, 华登国际董事总经理 Dr. Hing Wong, Managing Director(MD), Walden International
13:30-13:50		中芯聚源 Fortune-tech Capital Co., Ltd.
13:50-14:10	赋能半导体产品创新 Enabling Semiconductor Product Innovation	胡颖平, 元禾璞华董事总经理 Yingping Hu, Managing Director, Hua Capital
14:10-14:30	半导体热潮下中国半导体发展和投资机会 Semiconductor Development and Investment Opportunities in China under the Semiconductor Upsurge	苏仁宏, 湖杉资本创始合伙人 Tony Su, Founding Partner CEO, Allin Capital

14:30-14:50		北京中关村集成电路设计园
<b>先进封装与测试 (二)</b> <b>Advanced Packaging and Testing (II)</b>		
14:50-15:10	多芯片 3D 合封晶圆级集成封装技术- SmartPoser™ SmartPoser™ for Multi-chip 3DIC Integration	林正忠, 盛合晶微半导体 (江阴) 有限公司 VP 副总裁 ChengChung Lin, VP, SJ Semiconductor (JiangYin) Corp.
15:10-15:30		苏州华碧微科检测技术有限公司 Suzhou FALAB Test Technology Co., Ltd.
15:30-15:50		胜科纳米
15:50-16:10	在 WLP/PLP 量产型贴片机选择中的重要 考虑因素 Important Considerations of Selecting WLP & PLP Die PnP Tool For HVM	张迪, ASM 太平洋科技有限公司 Derek Zhang, Business Development Manager, ASM Pacific Technology Ltd.
16:10-16:30	功率器件中 UBM 层-化学镀的实际运用	黄雷, 深圳市创智成功科技有限公司总 经理
16:30-16:50	基于 TSV 工艺的先进封装技术 TSV Based Advanced Packaging Technology	周鸣昊, 华进半导体封装先导技术研发 中心有限公司市场总监 MingHao Zhou, Marketing Director, National Center for Advanced Packaging Co., Ltd.
16:50-17:10	异构封装在 AI 和超级计算中的应用 Heterogeneous IC Packaging for AI and Compute	王明波, 安靠科技大中华区销售和市場 副总监 Bibby Wang, Deputy Director of Greater China Sales & Marketing, Amkor Technology, Inc.
17:10-17:30	先进封装缺陷及失效案例解析 Advanced Packaging Defect and Failure Analysis Cases	高峰, 闳康技术检测 (上海) 有限公司 FA 工程部门经理 Otis Gao, FA Department Manager, Materials Analysis Technology (Shanghai) Ltd.
17:30-17:50	ATE 为你实现出色的多媒体音频/视频应 用 Enabling Multimedia-Oriented ATE Test System	李永煌, 致茂电子股份有限公司资深经 理 Spencer Lee, Senior Manager, Chroma ATE INC.
17:50-17:55	<b>幸运抽奖 Lucky Draw</b>	
18:30-20:00	<b>闭幕晚宴及交旗仪式</b> <b>Closing Banquet and Flag Handover Ceremony</b> 地点: 无锡太湖华邑酒店四楼新城厅 <b>Site: Xincheng Ballroom, 4F, Hualuxe Wuxi Taihu</b>	

2021年11月12日，星期五  
**Nov. 12, Friday, 2021**  
**专题论坛（五）**  
**Subject Forum (V)**

地点：无锡君来世尊酒店二楼8号会议室

Venue: Meeting Room 8, 1F, Worldhotel Grand Juna Wuxi

时间 Time	内容 Contents	演讲人 Lecturer
<b>EDA 与 IC 设计创新</b> <b>EDA and IC Design Service</b>		
主持人：沈磊，中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长 <b>Moderator: Lei Shen, Vice General Director, CSIA-ICCAD</b>		
08:40-09:00	Cadence 面向三维芯片设计规划、实现和系统级仿真的集成化解决方案 Cadence 3D-IC Multi-die Integrated Solution for 3D Design Planning, Implementation and System Level Analysis	邓立群，Cadence 数字集成电路自动化设计研发中心产品工程总监 Richie Deng, Product Engineering Director of Digital & Signoff Group, Cadence
09:00-09:20	西门子 EDA 如何协助开发智能汽车芯片 Siemens EDA Solutions for Smart Vehicle IC Design	李立基，西门子 EDA 亚太区技术总监 Lincoln Lee, Technical Director, PacRim, Siemens EDA
09:20-09:40	数字异构验证助力先进节点集成电路设计 Benefits of Heterogeneous Verification	林铠鹏，国微思尔芯资深副总裁 KP Lin, Senior VP, S2C Limited
09:40-10:00	汽车功能安全性 Automotive Functional Safety	周磊，新思半导体汽车电子功能安全性验证资深 AE 工程师 Lane.Zhou, Automotive Functional Safety Staff AE, Synopsys
10:00-10:20	全流程工具助力电源管理芯片设计方法学创新 Methodology Innovation of Power Management IC Design on Complete Analog EDA System	刘晓明，华大九天产品总监 Liu Xiaoming, Product Director, Empyrean Technology Co., Ltd.
10:20-10:40	蓄力向前，打造面向存储的全流程 EDA	李严峰，上海概伦电子股份有限公司执行副总裁 Yanfeng Li, EVP, Primarius Technologies Co., Ltd.
10:40-11:00	打通数字验证全流程，引领新一代 EDA (draft) Breakthrough Digital Verification Solution for Next Generation of EDA(draft)	黄武，芯华章科技产品市场总监 David Hwang, Product Marketing Director, X-EPIC
11:00-11:20	EDA 上云——加速中国“芯”时代 Accelerate Cloud Transformation - EDA on Azure	孙海亮，微软行业解决方案部总经理 Heidi Sun, Industry Solution Director, Microsoft
11:20-11:40	先进封装技术的发展趋势和对 EDA 的挑战 Advanced Package Technology Trends and Challenges for EDA Industry	苏周祥，芯和半导体高级技术支持总监 Zachary Su, AE Director, Xpedic Technology

11:40-12:00	汽车芯片多物理场电源完整性可靠性分析 Multiphysics Power Noise and Reliability Signoff for Automotive Applications	崔硕岳, Ansys 公司半导体事业部技术经理 Shuoyue Cui, Manager Application Engineering, Ansys
12:00-12:05	幸运抽奖 Lucky Draw	
12:05-13:10	自助午餐 Buffet Lunch	
主持人: 刘娜, 中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长 Moderator: Na Liu, Vice General Secretary, CSIA-ICCAD		
13:10-13:30	面向大规模 SoC 验证的 EDA IaaS 解决方案 An EDA IaaS Solution to Face SoC Verification Challenges	马超, 英诺达(成都)电子科技有限公司市场及业务拓展部副总裁 Chao Ma, VP of MBD, EnnoCAD Electronic Technology Co., Ltd.
13:30-13:50	业界独特的版图寄生参数分析工具 Viso Viso: An Unique Parasitic Exploration Tool for Layout Design	刘客, 芯师(上海)电子科技有限公司 AE 经理 Ke Liu, AE Manager, Silvaco China., Ltd.
13:50-14:10		中科芯云
14:10-14:30	与芯同行, 行芯 Signoff 工具链加速先进工艺设计收敛 Follow with IC Design, Phlexing EDA Tools Accelerate Signoff Closure at Advanced Nodes	贺青, 杭州行芯科技有限公司 CEO Qing He, CEO, Hangzhou Phlexing Technology Co., Ltd.
14:30-14:50	云端半导体协同创新 Semiconductor Collaborative Innovation on Cloud	周宇, 亚马逊 Kevin Zhou, Amazon Web Services
14:50-15:10	大规模集成光电子设计关键技术 Key Technologies for Large-scale Photonic Integrated Circuits (PICs) Design	郭进, 联合微电子中心 (CUMEC) 副总经理 Jin Guo, VP, United Microelectronics Center
15:10-15:30		摩尔精英
15:30-15:50	集成电路设计工艺协同优化完整方案: 流程、EDA 软件、自动化	伍宏, 墨研计算科学(南京)有限公司总经理 Hong Wu, CEO, Moyan Computational Science (Nanjing) Co., Ltd.
15:50-16:10	智能数据+平台帮助芯片设计企业精准触达目标用户, 助力国产替代 Intelligent Data + Platform Helps Chip Design Enterprises Accurately Reach Target Users and Help Domestic Alternatives	王新, Supplyframe 四方维市场总监 Shane Wang, Marketing Director, Supplyframe
16:10-16:30	智能云加速 IC 设计 Intelligent Cloud Accelerates IC Design	邓世友, 紫光云技术有限公司 CTO 办公室主任 Shiyue Deng, Director UniCloud CTO Office, UNICLOUD TECH CO., LTD



16:30-16:50	Altair 高性能计算驱动 EDA 流程优化高速提效 Altair High-performance Computing Drives EDA Process to High Speed Optimize and Efficiency	王轶华, Altair 企业计算部技术经理 Yihua Wang, Enterprise Computing Technical Manager, Altair
16:50-17:10	IC 设计企业如何系统性大幅提升研发效率——面向 EDA 行业应用的一站式 IC 设计研发云平台 How Could IC Design Companies Significantly Improve R&D Efficiency Systematically-a One-Stop IC Design R&D Cloud Platform	陈琳涛, 上海速石信息科技有限公司高级技术总监 Leo Chen, Senior Director, Shanghai FASTONE Information Technology Co., Ltd.
17:10-17:30	IoT 时代的超低功耗蓝牙模块设计 The Discussion of an Ultra-low Power BLE5 Module for IoT Application	冯琪, 苏州芯联成软件有限公司电路工程处经理 Qi Feng, Head of IC Analysis Department, Suzhou Silintech Company
17:30-17:50	良率驱动芯片制造全流程解决方案 Yield Driven Chip Manufacturability Solutions	俞宗强, 东方晶源微电子科技(北京)有限公司董事长及联合创始人 Zongchang Yu, Chairman of the Board, and Co-founder, Dongfang Jingyuan Electron Limited
17:50-17:55	幸运抽奖 Lucky Draw	
18:30-20:00	闭幕晚宴及交旗仪式 Closing Banquet and Flag Handover Ceremony 地点: 无锡太湖华邑酒店四楼新城厅 Site: Xincheng Ballroom, 4F, Hualuxe Wuxi Taihu	

2021年11月12日，星期五

**Nov. 12, Friday, 2021**  
**专题论坛（六）**  
**Subject Forum (VI)**

地点：无锡君来世尊酒店二楼12号会议室

Venue: Meeting Room 12, 1F, Worldhotel Grand Juna Wuxi

时间 Time	内容 Contents	演讲人 Lecturer
<b>FOUNDRY 与工艺技术</b> <b>Foundry and Process Technology</b>		
主持人：张力天，中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长 <b>Moderator: Litian Zhang, Vice General Director, CSIA-ICCAD</b>		
08:40-09:00	TSMC 的先进逻辑工艺和 3D 集成技术 TSMC's Leadership in Advanced Logic and 3D Integration Technology	蔡玥，台积电中国区业务发展副总监 Amy Cai, China Business Development Deputy Director, TSMC
09:00-09:20	联电先进特色工艺 UMC Advanced Specialty Technologies	陈剑波，和舰芯片制造（苏州）股份有限公司销售经理 Snowwolf Chen, Sales Manager, HeJian Technology (Suzhou) Co., Ltd.
09:20-09:40	先进特色工艺智联未来 Advanced Specialty Technologies Shape the Future	田明，上海华力微电子有限公司研发总监 Ming Tian, Senior Director of TD, HLMC
09:40-10:00	从电子到光子 From Electron to Photon	朱宇，格芯中国区业务发展总监 Fisher Zhu, Director of China Business Development, GlobalFoundries
10:00-10:20		华润微电子
10:20-10:40	3D 传感感知世界 3D Imager Sensing the World	方大晟，Tower Semiconductor 中国区销售总监 Dasheng, China Sales Director, Tower Semiconductor Ltd.
10:40-11:00	武汉新芯先进特色工艺的发展与创新 The Development and Innovation of XMC's Advanced Specialty Technologies	蒋国荣，武汉新芯集成电路制造有限公司代工业务处销售总监 Gary Jiang, Sales Director of Foundry Business, XMC
11:00-11:20		杨继业，上海华虹宏力半导体制造有限公司总监 Jiye Yang, Senior Director, ShangHai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing Corporation
11:20-11:40		欧洲微电子研究中心 IMEC

11:40-12:00		摩尔精英 MooreElite
12:00-12:05	幸运抽奖 Lucky Draw	
12:05-13:10	自助午餐 Buffet Lunch	
<b>IC 设计与应用 IC Design &amp; Application</b>		
主持人：樊晓华，中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长 Moderator: Xiaohua Fan, Vice General Director, CSIA-ICCAD		
13:10-13:30		紫光展锐 UNISOC
13:30-13:50	基于 NOR Flash 技术的人工智能终端推理芯片 A NOR Flash Based Inference IC for Low-Power Edge Devices	吕向东，恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事长 Xiangdong Lu, CEO, Zbit Semiconductor, Inc.
13:50-14:10	高性能 GPU 的应用及架构特点 Applications and Architecture Features of High Performance GPU	付轩，沐曦集成电路（上海）有限公司架构师 Gary Fu, Architect, MetaX Integrated Circuits (Shanghai) Co., Ltd.
14:10-14:30	国家集成电路芯火平台的探索 Exploration of National Xinhuo Innovation Base(Platform)	吕会军，南京集成电路产业服务中心（ICisC）副总经理 Huijun Lv, Deputy GM, Nanjing IC Industry Service Center Co., Ltd.
14:30-14:50	HC9001 第五代 PCIe 高端存储控制芯片 HC9001 PCIe Gen5 Nand Flash Controller Chip	庄健民，江苏华存电子科技有限公司副总经理 Marco Chuang, VGM, Jiangsu Huacun Electronic Technology Co., Ltd.
14:50-15:10	高性能可重构网络安全芯片 High-performance Reconfigurable Network Adaptor Chip	朱敏，无锡沐创集成电路设计有限公司 CEO Min Zhu, CEO, Wuxi Micro Innovation Integrated Circuit Design Co., Ltd.
15:10-15:30	WTM2101: 存算一体芯片 WTM2101: Computing-in-memory SoC	王绍迪，北京知存科技有限公司 CEO Shaodi Wang, CEO, Beijing Zhicun (WITIN) Technology Co., Ltd.
15:30-15:50	高性能可重构 GP-GPU 芯片——RPP R8 High performance reconfigurable GP - GPU(RPP R8)	李原，珠海市芯动力科技有限公司 CEO Yuan Li, CEO, Zhuhai Azurengine Technology Co., LTD.
15:50-16:10	蓝牙低功耗（BLE）技术特点及其应用发展趋势 Technical Features and Application Trends in Bluetooth Low Energy (BLE)	张书迁，北京昂瑞微电子技术有限公司市场部高级总监 Shuqian Zhang, Senior Marketing Director, Beijing OnMicro Electronics Co., Ltd.
16:10-16:30	存储核芯拓展新兴领域 The Advanced Memory in New Emerging Marketing	薛霆，北京兆易创新科技股份有限公司存储事业部市场经理 Tim Xue, Marketing Manager, GigaDevice Semiconductor (Beijing) InC

16:30-16:50	新数据中心网络中的芯方案 Chip Solution in New Data Center Network	陈永洲, 烽火通信科技股份有限公司 技术专家 Yongzhou Chen, Technician, FiberHome Telecommunication Technologies, Co., Ltd.
16:50-17:10	方寸用芯片构建网络空间安全基石 TIH Building the Cornerstone of Cyberspace Security with Chip	叶智辉, 山东方寸微电子科技有限公司 执行副总裁 Jason Ye, EVP, TIH Microelectronics Co., Ltd.
17:10-17:30	高性能自动驾驶芯片赋能汽车智能化转 型 High-performance AD Chip Enabling Intelligent Transformation of Automobile	杨宇欣, 黑芝麻智能 CMO Rock Yang, CMO, Black Sesame Technologies (Shanghai) Co., Ltd.
17:30-17:50	AI 计算: 从物理感知到知识聚合 AI Computing: From Physical Perception to Knowledge Consolidation	徐宁仪, 上海阵量智能科技有限公司 CEO Michael Xu, CEO, ShangHai PowerTensors Intelligent Technology Co., Ltd.
17:10-317:15	幸运抽奖 Lucky Draw	
18:30-20:00	闭幕晚宴及交旗仪式 Closing Banquet and Flag Handover Ceremony 地点: 无锡太湖华邑酒店四楼新城厅 Site: Xincheng Ballroom, 4F, Hualuxe Wuxi Taihu	